

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹宏力半導體有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹宏力半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的

- 1、 2026年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
- 2、 關於2026年半年度計提資產減值準備的公告
- 3、 關於2026年度「提質增效重回報」行動方案的半年度評估報告

僅供參閱。

承董事會命
華虹宏力半導體有限公司
董事會主席兼執行董事
白鵬博士

中國上海，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

白鵬(董事會主席兼總裁)

非執行董事：

葉峻

孫國棟

陳博

熊承艷

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩太平紳士

封松林

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹宏力
港股简称：华虹宏力

公告编号：2026-045

华虹宏力半导体有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,775.00 万股，每股发行价格为人民币 52.00 元，募集资金总额为 2,120,300.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 28,232.30 万元（含税）后，募集资金净额为 2,092,067.70 万元，上述资金于 2023 年 7 月 31 日已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第 60985153_B02 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际收到的募集资金金额	2,094,241.40
减：支付发行费用	1,226.97
减：募投项目累计支出金额	1,526,419.05
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	21,750.82
期末募集资金专户余额	588,346.19

注：上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金管理协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2023年7月，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。2023年9月，公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、国泰君安、海通证券分别同招商银行股份有限公司上海分行、国家开发银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、中国工商银行股份有限公司上海浦东分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与华虹半导体制造（无锡）有限公司、国泰君安、海通证券分别同中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司、国泰君安、海通证券分别同国家开发银行江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储六方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	存款方式	金额（人民币万元）
招商银行股份有限公司上海分行	NRA999017055210902	活期存款	308,523.84
招商银行股份有限公司上海分行	121911282310518	活期存款	7,672.04

国家开发银行上海分行	31000109000000100092	活期存款	1,920.70
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999988	活期存款	135,907.53
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行营业部	1001280929300150002	活期存款	134,317.56
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999988	活期存款	0.00
国家开发银行江苏省分行	32100109000000000037	活期存款	0.49
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600013001312349	活期存款	3.80
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543609988888	活期存款	0.08
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259401	活期存款	0.15
合计			588,346.19

注：上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在募投项目实施期间，通过银行电汇、信用证等结算方式，以自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额支付，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

特此公告。

华虹宏力半导体有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2026 年半年度

单位：人民币万元

募集资金净额				2,092,067.70		本年度投入募集资金总额					42,449.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,526,419.05	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华虹制造（无锡）项目	否	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	6,084.71	1,242,736.42	-7,263.58	99.42	不适用	不适用	不适用	否
8 英寸厂优化升级项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	16,248.40	65,914.61	-134,085.39	32.96	不适用	不适用	不适用	否
特色工艺技术创新研发项目	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	20,116.36	117,722.73	-132,277.27	47.09	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,045.30	45.30	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超额募集资金	否	-	292,067.70	292,067.70	0.00	0.00	-292,067.70	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,800,000.00	2,092,067.70	2,092,067.70	42,449.46	1,526,419.05	-565,648.65	72.96	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况							

注1：补充流动资金截止报告期末累计投入金额超出该募集资金总额45.30万元，系募集资金专户产生的利息。

华虹宏力半导体有限公司

关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华虹宏力半导体有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 26 日审议通过了 2026 年半年度计提资产减值准备相关事宜，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并范围内的各项资产和存货等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对上述资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。同时对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值损失金额内进行转回。

公司本次计提信用减值损失 1,660.45 万元，计提资产减值损失 38,572.41 万元，转销资产减值损失 36,818.99 万元。计提及转销各项资产减值准备合计将减少公司 2026 年半年度利润总额 3,413.87 万元。具体情况如下所示：

单位：人民币万元

序号	项目	计提金额	转销金额	备注
1	信用减值损失	1,660.45	-	应收票据坏账、应收账款坏账损失
2	资产减值损失	38,572.41	36,818.99	存货跌价损失
合计		40,232.86	36,818.99	/

二、2026 年半年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2026 年半年度计提信用减值损失金额 1,660.45 万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。2026 年半年度计提存货跌价损失金额 38,525.98 万元。同时，由于报告期内部分前期已计提减值的产品已实现对外出售 2026 年半年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备 36,818.99 万元。

资产负债表日，公司对固定资产等长期资产于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。2026 年半年度公司计提固定资产减值准备 46.43 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提及转销各项资产减值准备将减少公司 2026 年半年度利润总额 3,413.87 万元。公司本次计提、转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司实际情况。

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

华虹宏力半导体有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

华虹宏力半导体有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

华虹宏力半导体有限公司（以下简称“公司”，曾名为华虹半导体有限公司）为贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动要求、践行“以投资者为本”的发展理念，于 2026 年 3 月 27 日发布了《华虹半导体有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续优化经营管理、规范公司治理和提升投资者回报。现将 2026 年上半年主要举措的落实情况报告如下：

一、深耕主业，提升经营质效

2026 年上半年，公司秉持“8 英寸+12 英寸”、先进“特色 IC+功率器件”的发展战略，积极应对全球半导体市场的结构性机遇，持续推进五大特色工艺平台迭代升级，研发成果持续增长，收入创历史新高，盈利能力显著提升。

技术研发方面，40 纳米 eFlash 工艺平台实现风险量产，55 纳米 eFlash 车规平台推进产品导入；40 纳米超低功耗特色工艺实现规模量产；新一代小 Pitch IGBT 平台、高压超级结及 Super IGBT 系列工艺进入量产阶段；与海外头部客户合作的 40 纳米 MCU 产品实现规模量产。公司持续拓展汽车电子、高端消费、工业控制及新能源等应用领域，持续巩固与强化核心竞争力。2026 年上半年，公司在降本增效的同时，继续高度重视研发投入，上半年研发投入达 9.13 亿元，

新增获授权的国内外发明专利 162 个，累计获授权的国内外专利达到 4,997 项。

经营业绩方面，公司上半年实现营业收入 95.74 亿元，同比增长 19.4%，创下历史新高，截止 2026 第二季度已连续 10 个季度实现营业收入环比增长。公司坚定推进“8 英寸+12 英寸”协同发展战略，持续优化产能布局。8 英寸产线保持高效运营，12 英寸产能持续爬坡。截至 2026 年 6 月 30 日，无锡二期项目（Fab 9）8.3 万片/月规划产能所需工艺设备已全部完成搬入，正在推进安装调试，计划于第三季度末达到规划产能目标。同时，公司持续深化精益管理策略、巩固降本增效举措，上半年有效应对了国际贸易摩擦风险，实现了成本节降与盈利改善。2026 年上半年，公司实现归母净利润 3.99 亿元，较去年同期大幅增长 436.7%，实现扣非归母净利润 3.16 亿元，较去年同期大幅增长 470.3%。

二、优化公司治理，重视股东回报，提升资本市场品牌形象

2026 年上半年，公司严格遵守沪港两地上市规则，持续完善治理制度和规范运作机制。公司于 2026 年上半年完成公司更名及证券简称变更，统一沪港两地股票证券简称；并于 8 月启用公司新 LOGO，提升公司品牌形象和影响力。

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，公司已根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等的有关规定，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事会及各专门委员会严格依规履职，并持续加强对控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的合规培训与履职监督，不断提升规范运作水平。

公司高度重视股东回报，积极拓展包括并购、业务拓展等在内的多维措施，让投资者共享公司发展成果，切实提升投资者的获得感。2026 年上半年，公司重大资产重组事项取得重大进展：本次交易已经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。本次交易完成后，公司将新增约 3.8 万片/月的 12 英寸晶圆产能，增厚公司收入与净利润，并进一步强化在逻辑、嵌入式闪存等配套工艺，客户资源及供应链等方面的协同优势。

三、提升信息披露水平，加强投资者沟通

公司严格履行信息披露义务，持续优化内部信息报送和重大事项披露流程，持续做好与监管机构、股东、董事及高级管理人员等的高效沟通。2026 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

此外，公司亦秉持“平等对待所有投资者”的原则，通过股东大会、定期业绩说明会、线下路演、投资者热线、“上证 E 互动”等多种渠道与各类投资者保持沟通，在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任

与支持，增强资本市场认同感。2026 年上半年，公司已举办业绩说明会 2 次，及时回应市场关切。同时，公司在今年上半年召开的 2026 年第一次临时股东大会和 2026 年股东周年大会中，对涉及影响中小投资者重大利益的事项已对中小投资者的投票情况单独统计，并及时公告了计票结果，切实保障中小股东的合法权益。

四、其他说明

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案各项举措总体推进顺利，在工艺平台迭代升级、产能建设与优化、降本增效、重大资产重组实施、规范公司治理、完善信息披露与投资者沟通等方面均取得了阶段性成果，为公司长期稳健发展奠定了坚实基础。

以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。公司将持续评估、不断优化“提质增效重回报”行动方案并持续推进方案的落地，及时履行信息披露义务。公司也将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、完善的信息披露与积极的投资者交流，回馈广大投资者的信任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

华虹宏力半导体有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日